

# 低誘電銅張積層板 『Modified-PI(MPI)タイプ』

## 使用例

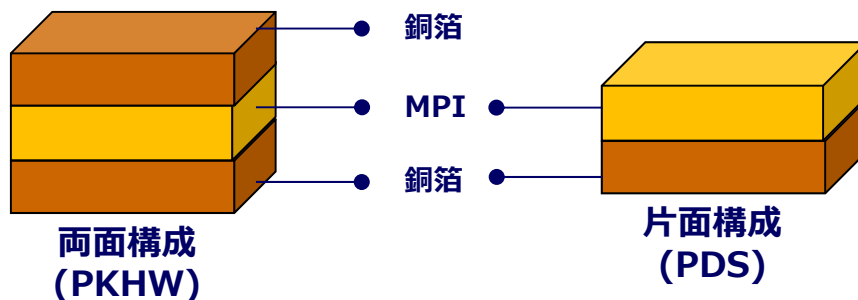
- ・フレキシブル高速基板  
(アンテナ回路基板)



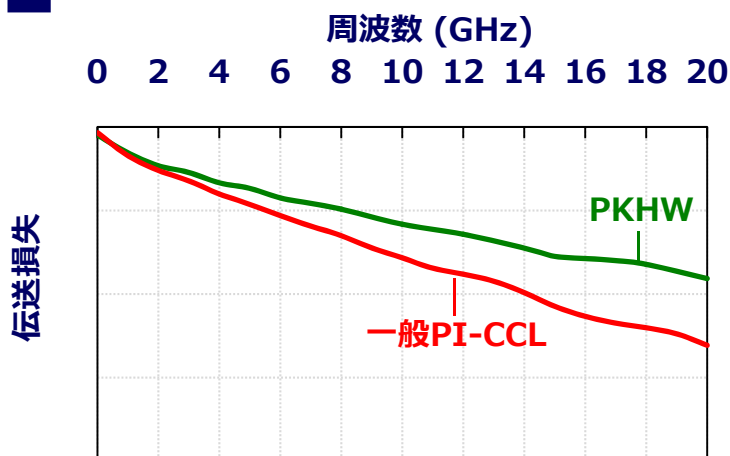
## 特徴

- ・ポリイミド材料でトップクラスの誘電特性(低Df)、低吸水性を有します。
- ・耐熱性が高く、部品実装、リフロー工程への適用が可能です。
- ・屈曲性に優れ、繰り返し折り曲げが必要な部位に使用可能です。

## 構成



## 特性



試料構成 : マイクロストリップ  
インピーダンス : 設計値50±5Ω  
測定環境 : 23°C、50%RH  
絶縁層厚さ : 50μm  
銅箔厚さ : 12μm  
回路長 : 100mm

	単位	PKHW	PDS
誘電率	-	3.50	3.30
誘電正接	-	0.003	0.003
吸水率	wt%	0.7	0.7
引きはがし強さ (90°)	N/cm	12.0	10.0
はんだ耐熱	-	340°C<	340°C<